

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.100.25; 31.080.01; 31.240 **Říjen 2010**

**Rozměrová normalizace polovodičových součástek -
Část 6-18: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder
polovodičových součástek
pro povrchovou montáž - Konstrukční pokyn
pro návrh pouzder BGA**

**ČSN
EN 60191-6-18**

35 8791

idt IEC 60191-6-18:2010 + idt IEC 60191-6-18:2010/Cor.1:2010-05

Mechanical standardization of semiconductor devices -

Part 6-18: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages -

Design guide for ball grid array (BGA)

Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs -

Partie 6-18: Regles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des dispositifs a semiconducteurs pour montage en surface - Guide de conception pour les boîtiers matriciels a billes (BGA)

Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen -

Teil 6-18: Allgemeine Regeln für die Erstellung von Gehäusezeichnungen von SMD-Halbleitergehäusen - Konstruktionsleitfaden für Ball-Grid-Array (BGA)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60191-6-18:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60191-6-18:2010. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma poskytuje společné výkresy a rozměry pro všechny typy pouzder s vývody v provedení jako pole kulových vývodů (BGA). Rozteč mezi vývody je jeden milimetr nebo více. Tvar pouzdra je čtvercový.

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: VUT FEKT Brno, IČO: 00216305

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.